

2026 年 3 月期 個人株主様向け 会社説明会

配信期間：2026 年 1 月 22 日～1 月 29 日

太陽ホールディングス株式会社

東証プライム 4626



本資料の如何なる情報も、弊社株式の購入や売却などを勧誘するものではありません。また、本資料に記載された意見や予測等は、資料作成時点での弊社の判断であり、その情報の正確性を保証するものではなく、今後、予告なしに変更されることがあります。万が一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、弊社は一切責任を負うものではありません。

本日のご説明

- ① 会社概要・事業概況
- ② 長期経営構想・中期経営計画
- ③ 各事業の取り組み
- ④ 人的資本への投資
- ⑤ 株主還元・資本政策



会社概要・事業概況

会社概要

会社名

太陽ホールディングス株式会社

設 立

1953 年 9 月 29 日

本 社

東京都豊島区西池袋一丁目 11 番 1 号
メトロポリタンプラザビル 16 階

従業員数

連結 2,485 名 / 単体 171 名 (25 年 3 月末)

業 績

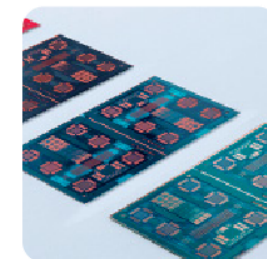
売上高 119,010 百万円 (25 年 3 月期)
営業利益 22,067 百万円 (25 年 3 月期)

事 業

- ・エレクトロニクス事業
- ・医療・医薬品事業
- ・ICT&S 事業 (ICT 事業、ファインケミカル事業、エネルギー事業及び食糧事業等)

株式上場

2001 年 1 月 証券コード 4626 プライム市場



当社の特長

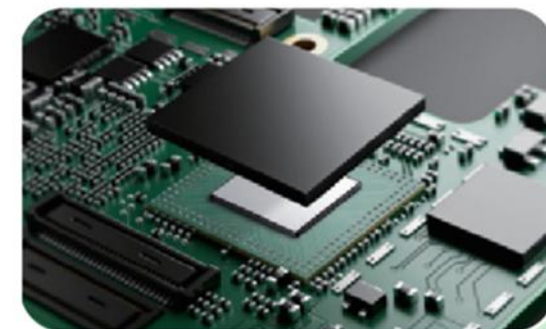
世界シェア No.1 の化学メーカー

プリント基板や半導体パッケージに欠かせない
ソルダーレジストでシェア約 6 割



半導体パッケージ用製品で高収益

半導体パッケージ向け製品が事業成長に大きく寄与
半導体関連業種として「日経半導体株指数」構成銘柄に選定



ニッチトップから医薬事業への展開

電子機器だけでなく医薬事業に参入し第二の柱へ成長



高配当（株主資本配当率 DOE：5% 以上維持）

総還元性向 100% を目安とした株主還元を実施
（少なくとも 2028 年 3 月期まで）

当社グループの事業セグメント

エレクトロニクス事業（エレキ事業）

プリント基板(PCB)用部材を始めとする電子部品用
化学品部材の開発・製造販売及び仕入販売



医療・医薬品事業（医薬事業）

医療用医薬品の製造販売・製造受託、
歯科技工物の製造販売



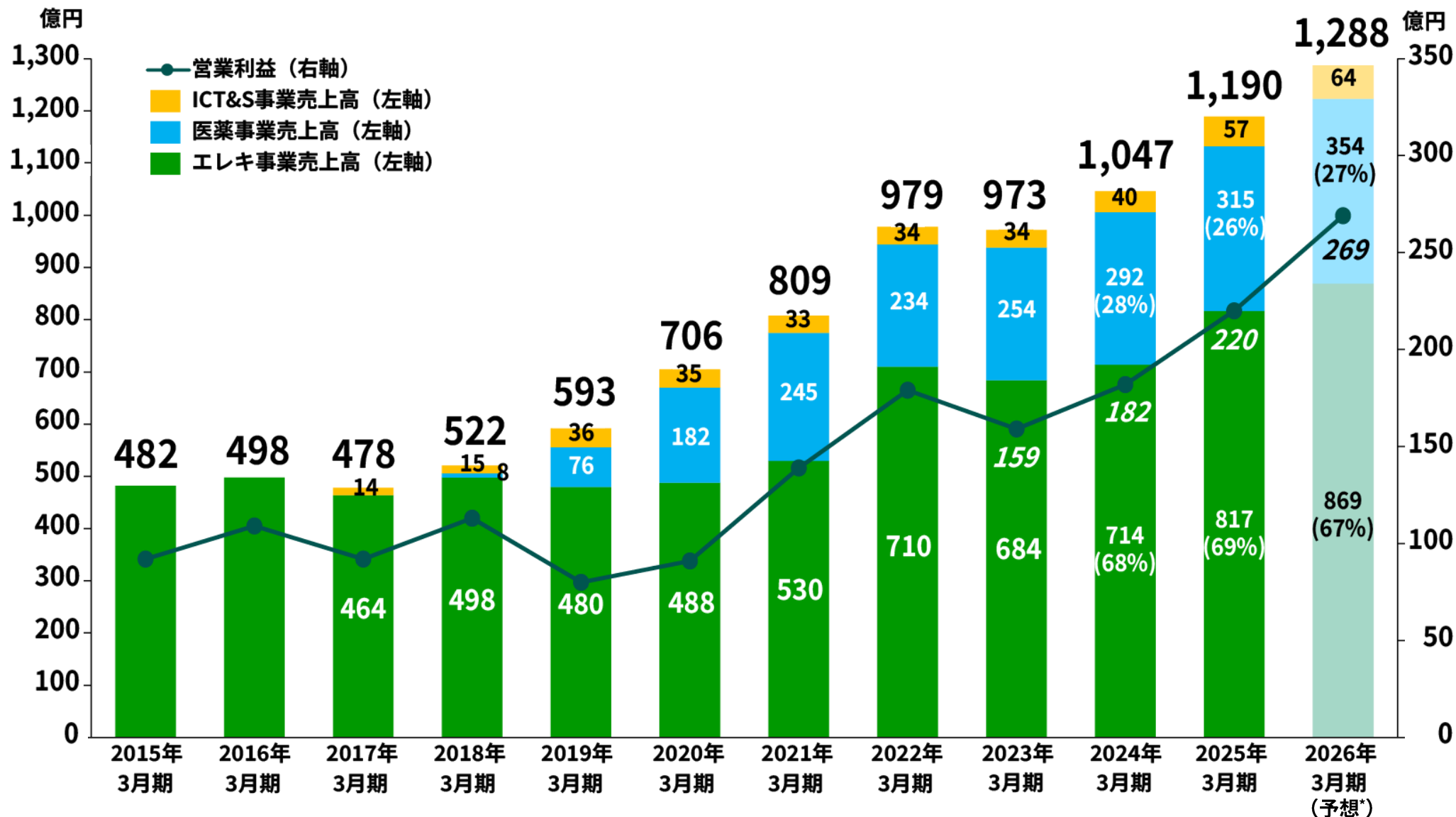
ICT&S 事業

ICT 事業、ファインケミカル事業、エネルギー事業
及び食糧事業等



通期業績推移

通期業績推移：売上高・営業利益



★ 円・USD レート：上半期(実績) 146.5 円、下半期(期初業績予想据え置き) 145.0 円

グループ拠点一覧



各種構成銘柄への選定

- 「JPX 日経インデックス 400」「日経半導体株指数」の構成銘柄に選定されています。*

JPX 日経インデックス 400

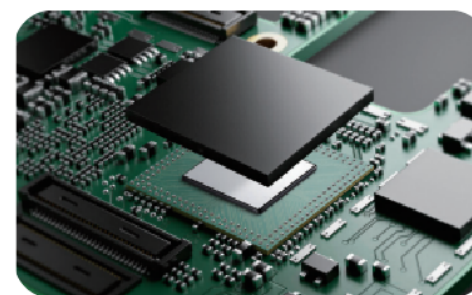


概要

対象銘柄	東京証券取引所上場銘柄
選定基準	【定量指標】 時価総額、直近 3 年間の株式売買金額、 3 年平均 ROE、3 年累積営業利益 等 【定性指標】 女性役員の選任、決算情報の英文資料 開示 等
選定期間	年 1 回定期見直し 8 月末に銘柄入れ替え

* 2026 年 1 月 15 日現在

日経半導体株指数



概要

対象銘柄	東京証券取引所上場銘柄
選定基準	日経 NEEDS 業種分類で半導体関連業種に属 する銘柄のうち、時価総額が大きい 30 銘柄
選定期間	年 1 回定期見直し 11 月末に銘柄入れ替え



長期経営構想 ・中期経営計画

長期経営構想 Beyond Imagination 2030

- 当社は 2021 年に、長期経営構想 Beyond Imagination 2030 を策定しました。
- 2025 年にはさらなる企業価値向上に向けて、長期経営構想を踏襲した中期経営計画として新たな財務目標とそのロードマップを策定しています。

基本方針

- 1 多様化する組織や社会に対応する自律型人材の育成・活用
- 2 エレクトロニクス事業の継続した成長と新規事業領域の創造
- 3 医療・医薬品事業の更なる成長
- 4 デジタルトランスフォーメーションによる進化と変革
- 5 新たな事業の創出
- 6 戦略的な M&A
- 7 SDGs(持続可能な開発目標)への取り組み強化

2030 年 当社の目指す姿

電子機器用部材事業、医療・医薬品事業を中心に成長すると同時に、エネルギー事業、食糧事業、DX にも積極的に取り組む

2031 年 3 月期目標

ROE
(自己資本利益率) **30%**

DOE
(株主資本配当率) **5% 以上維持**

中期経営計画の財務目標

- 中期経営計画期間における財務目標は以下のとおりです。

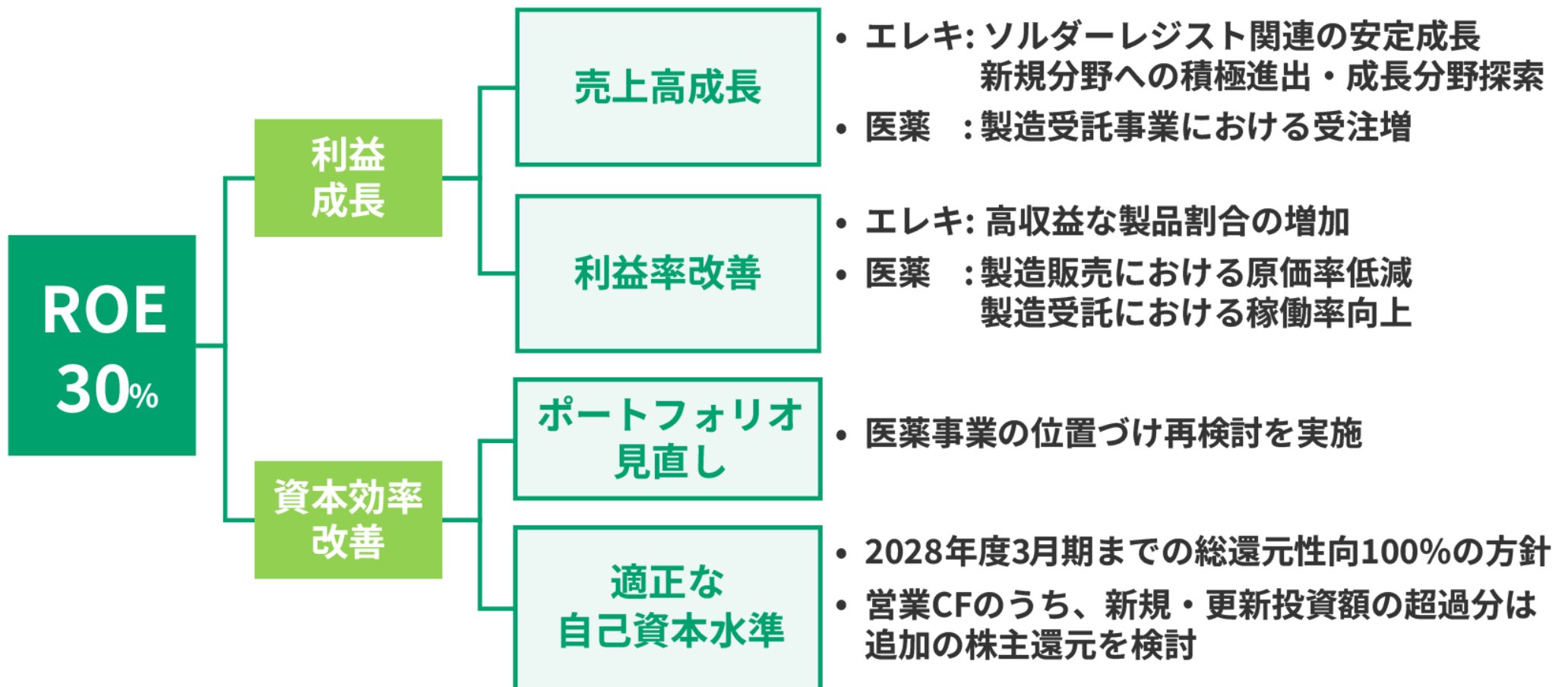
財務目標	2025年3月期 実績	2031年3月期 目標
売上高	1,190億円	1,800億円
営業利益 (営業利益率)	220億円 (19%)	470億円 (26%)
EBITDA (EBITDAマージン)	317億円 (27%)	580億円 (32%)
ROE[当期純利益/自己資本]	10.6%	30%
(参考)期中平均為替レート	1USD=152.5円	1USD=145.0円
(参考)為替感応度 *	売上高 +5億円	売上高 +8億円

* 為替が1ドルあたり1円円安に振れた場合のエレクトロニクス事業売上高の変化額

ROE 目標達成に向けた取り組み

- エレキ事業及び医薬事業それぞれの成長と、全社における資本効率改善により、2031年3月期における ROE30% の達成を目指します。

資本収益性向上のドライバー



主要事業別の財務目標

- エレキ事業及び医薬事業はともに売上高・営業利益の成長を想定しています。

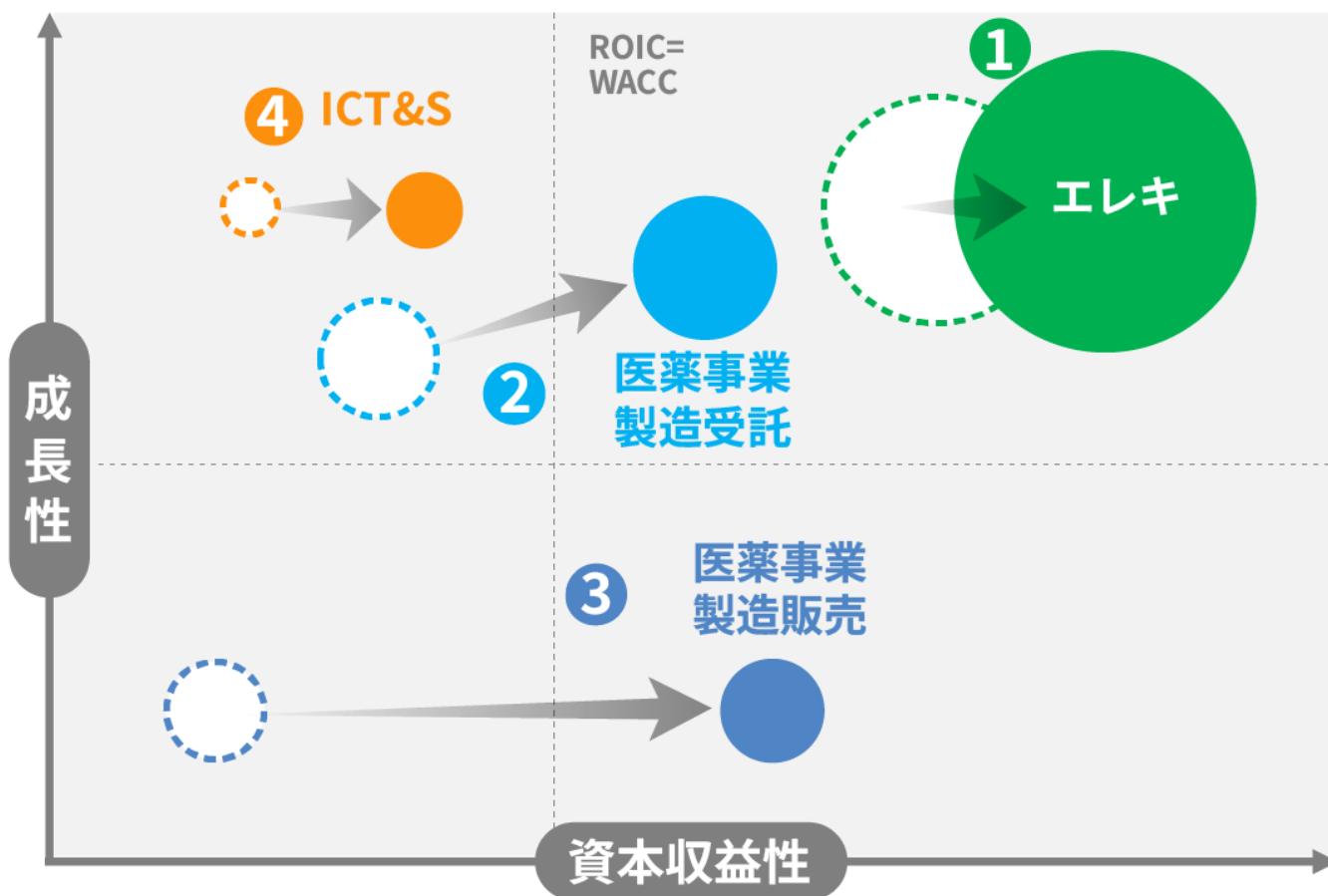
単位：億円		2025年3月期 実績		2031年3月期 目標	
セグメント	財務項目	金額	利益率	金額	利益率
連結	売上高	1,190	—	1,800	—
	営業利益	220	19%	470	26%
	EBITDA	317	27%	580	32%
エレキ 事業	売上高	817	—	1,280	—
	営業利益	214	26%	390	30%
	EBITDA	251	31%	440	34%
医薬 事業	売上高	315	—	430	—
	営業利益	20	6%	90	21%
	EBITDA	70	22%	130	30%

事業ポートフォリオの検討

- エレキ事業を引き続き当社におけるコア事業と位置づけ、医薬品製造受託事業の収益性改善に取り組みます。
- 医薬品製造販売事業は、抜本的な収益性改善に取り組み、戦略的選択肢も検討します。

円の大きさは売上規模のイメージ

○ 現状(2025年3月期) ● 目指す姿(2031年3月期)



① エレキ事業

コア事業 売上高の拡大に伴い
利益率・資本収益性の向上

② 医薬事業 製造受託

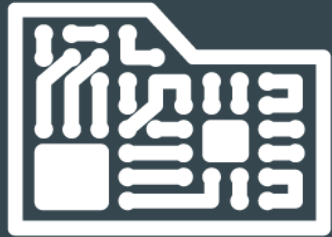
収益性改善事業
計画期間に高い成長率を見込み、
諸施策が実を結ぶフェーズに

③ 医薬事業 製造販売

改革・戦略的選択肢検討事業
戦略的選択肢検討と同時に、投資
を抑制し資本収益性の改善を図る

④ ICT&S事業

グループ貢献事業 エレキ/医療・
医薬品事業への運営上の貢献



エレクトロニクス事業

エレクトロニクス事業の特長

エレキ事業

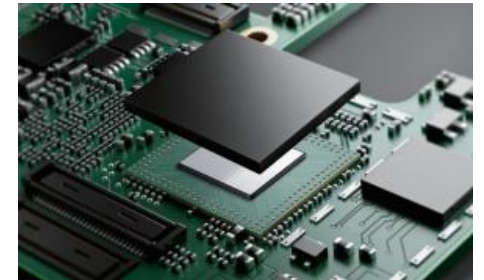
世界シェアNo.1の化学メーカー

プリント基板や半導体パッケージに欠かせない
ソルダーレジストでシェア約6割



半導体パッケージ基板用部材で高収益

半導体市場の成長を受け、
半導体パッケージ向け製品が業績をけん引



車載関連部材は電動化・電装化により増加

EV等の電動化、自動運転に伴う電装化により、自動車1台当たりの
基板面積が増加することでソルダーレジストの使用量は増加

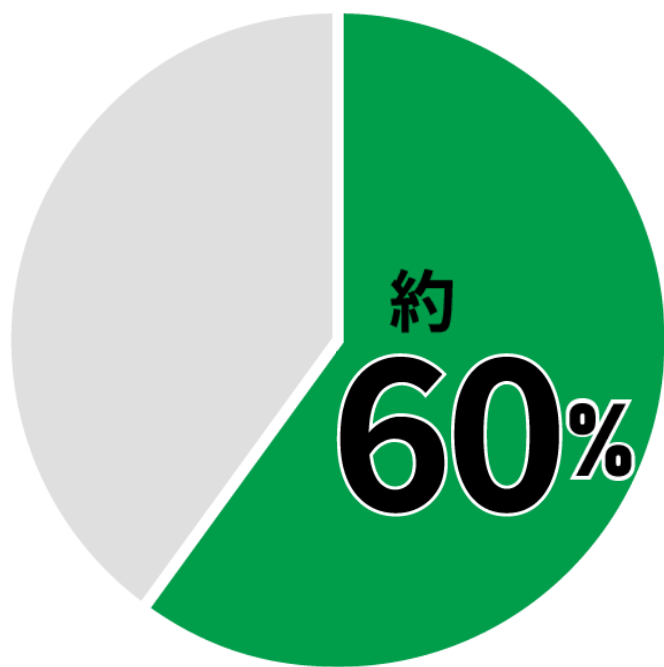


売上高・営業利益率推移

エレキ事業

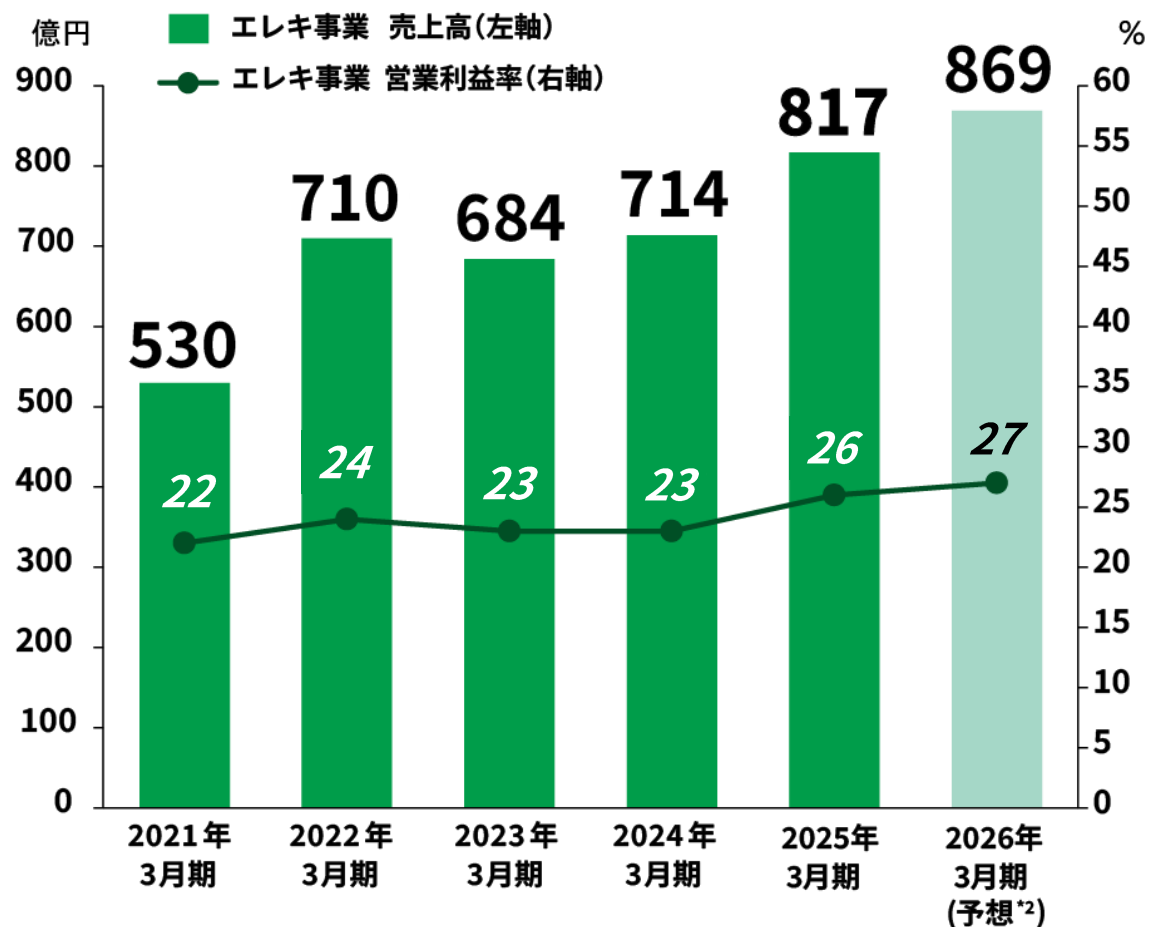
- エレクトロニクス事業は、主力製品のソルダーレジストの市場において世界シェア約 60% を有し、高い売上高成長、営業利益率を誇ります。

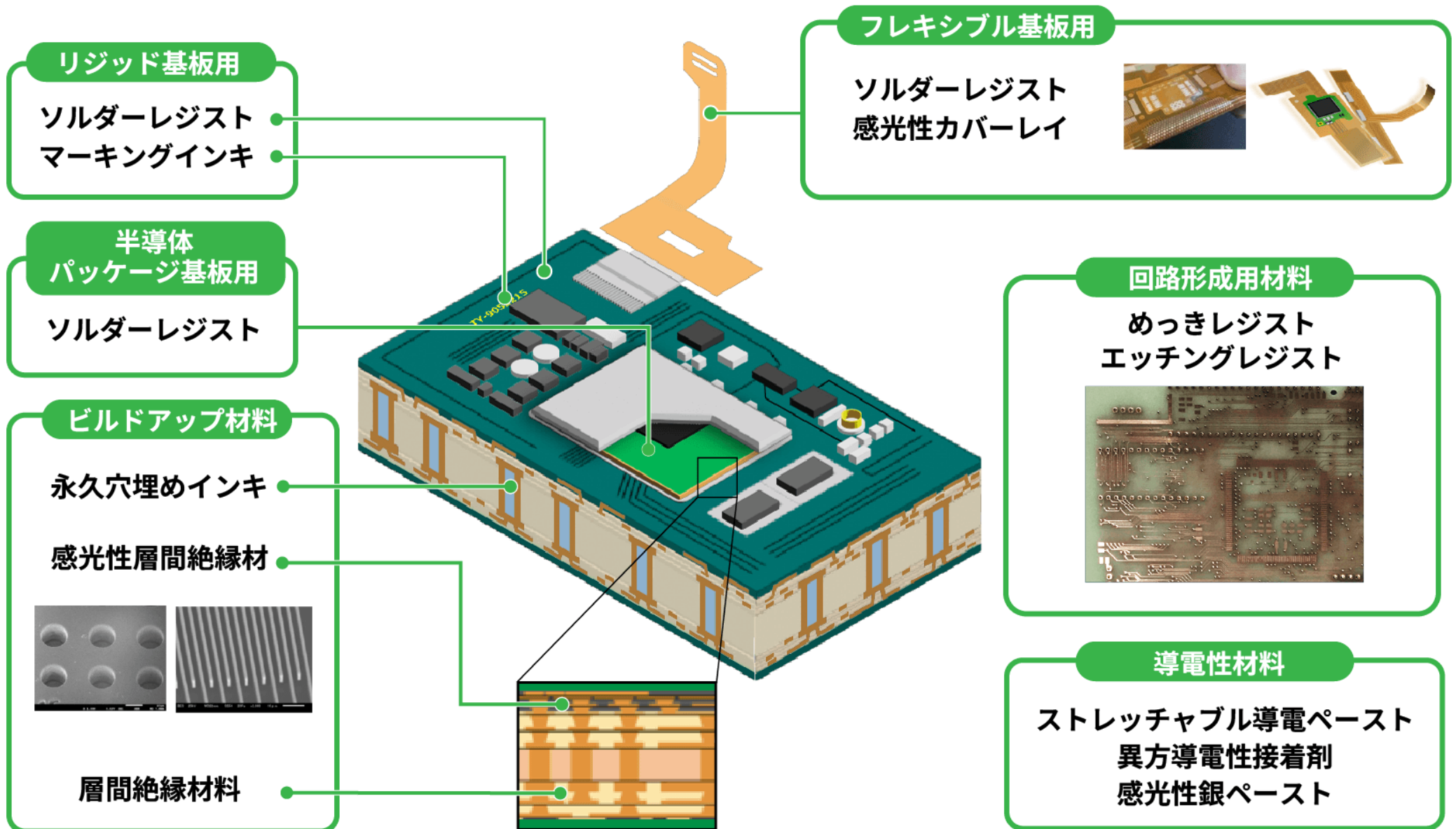
ソルダーレジスト 世界シェア^{*1}



*1 当社調査値

*2 円・USD レート：上半期(実績) 146.5 円、下半期(期初業績予想据え置き) 145.0 円

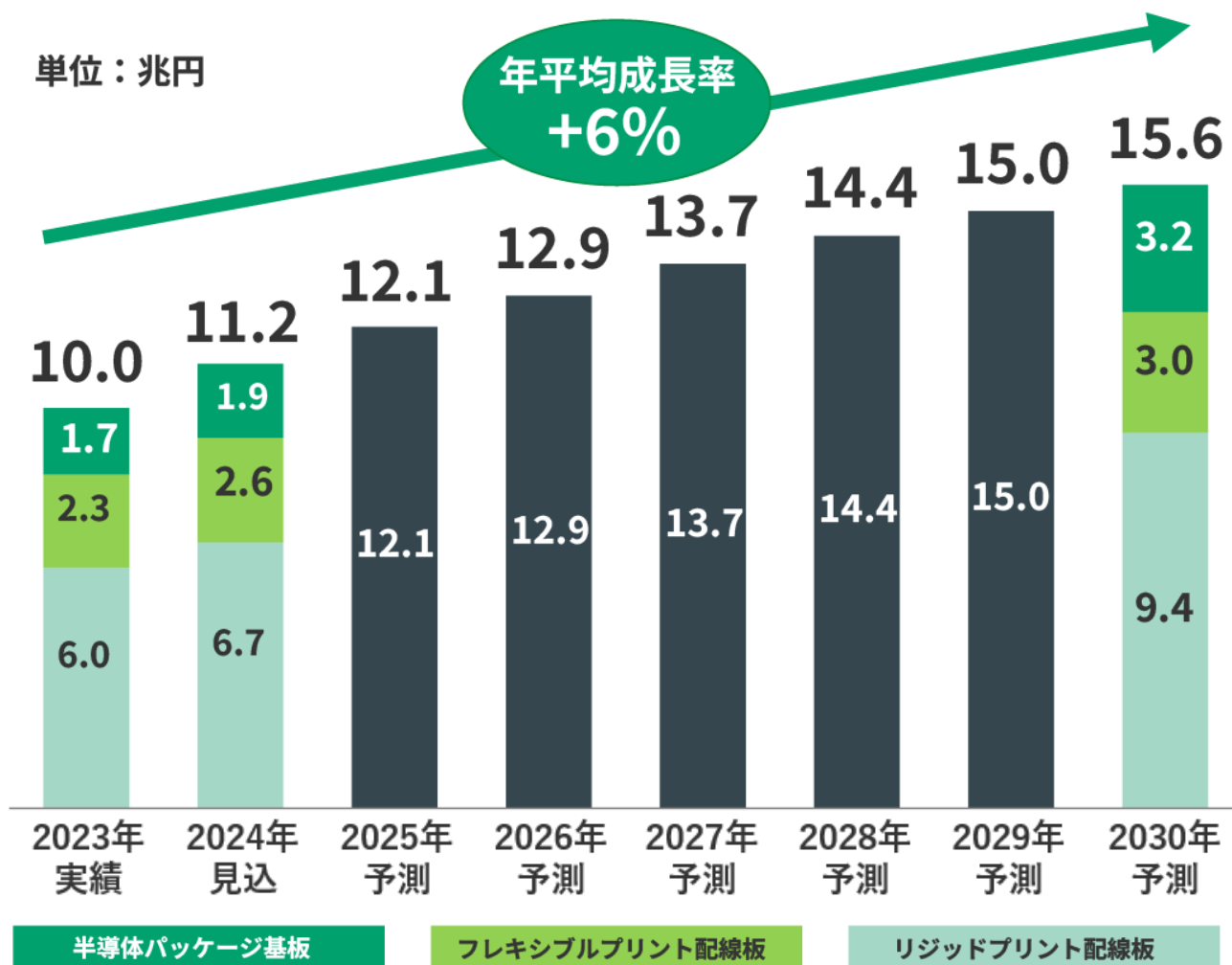




プリント基板市場規模推移・予測

エレキ事業

- 当社ソルダーレジストの顧客の市場であるプリント配線板市場は、2030年にかけて6年間で年平均6%、特に半導体PKG基板では年平均9%の成長が期待されます。



年平均成長率(2024年-2030年)

半導体
パッケージ基板 **9%**

フレキシブル
プリント配線板 **2%**

リジッド
プリント配線板 **6%**

出典「2024エレクトロニクス実装ニューマテリアル便覧」株式会社富士キメラ総研

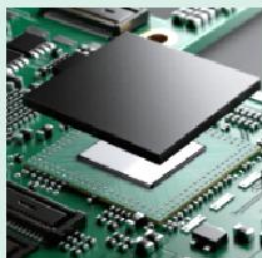
エレクトロニクス事業の成長戦略

エレキ事業

- ソルダーレジスト (SR) の市場拡大と新製品・新規事業を迅速に立ち上げることで、永続的な成長を目指します。

新規市場

用途展開の推進



- 既存技術の電子部品への用途展開
- SR 技術の半導体プロセス材料への用途展開

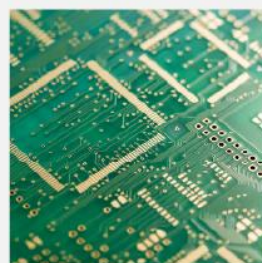
新規事業の創出



- ウェアラブル端末用部材
- ディスプレイ用部材
- CVCによるシーズ技術の探索

既存市場

SRの顧客基盤強化



- 既存市場での認定・維持を継続
- 高付加価値品比率向上による利益率向上

迅速な新製品上市の継続



- 層間絶縁材
- 感光性カバーレイ
- ガラスコア基板用部材
- インターポーザ用部材

既存技術

新規技術

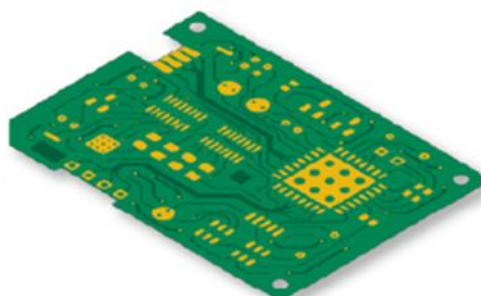
太陽インキ製造株式会社 取り組みのご紹介

ソルダーレジストとは？

- ソルダーレジストは、さまざまな電子部品を搭載したプリント基板の表面を覆い、回路パターンを保護する絶縁膜となるインキです。



ソルダーレジスト塗布前



ソルダーレジスト塗布後



部品実装後

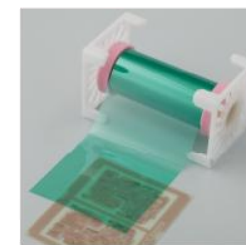
ソルダーレジストの主な役割

- 不要部分へのはんだの付着防止
- ほこり、熱、湿気などから回路パターンを保護
- 回路パターン間の電気絶縁性の維持

製品の性状



液状製品



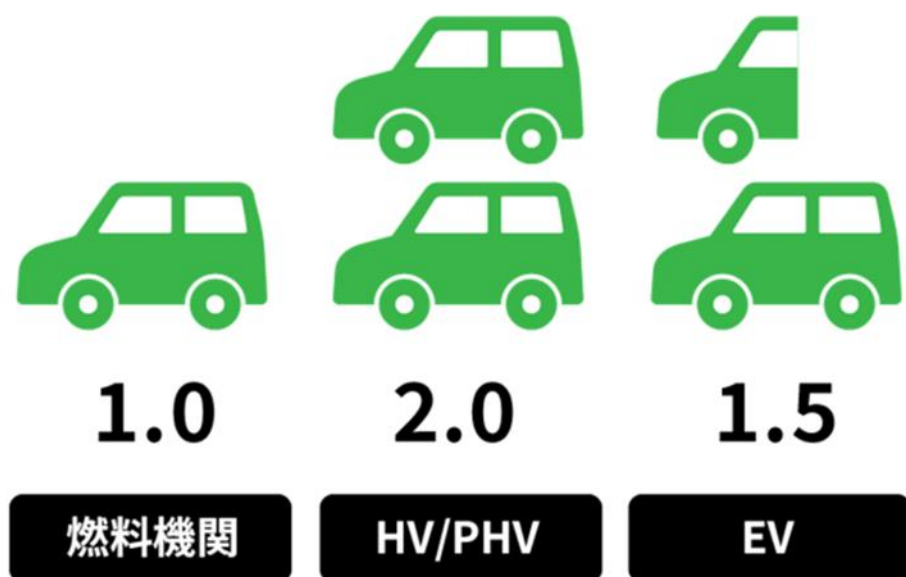
ドライフィルム製品

- あらゆるエレクトロニクス製品に利用されるプリント基板に欠かせない
ソルダーレジストを通じ、エレクトロニクスの発展に寄与しています。

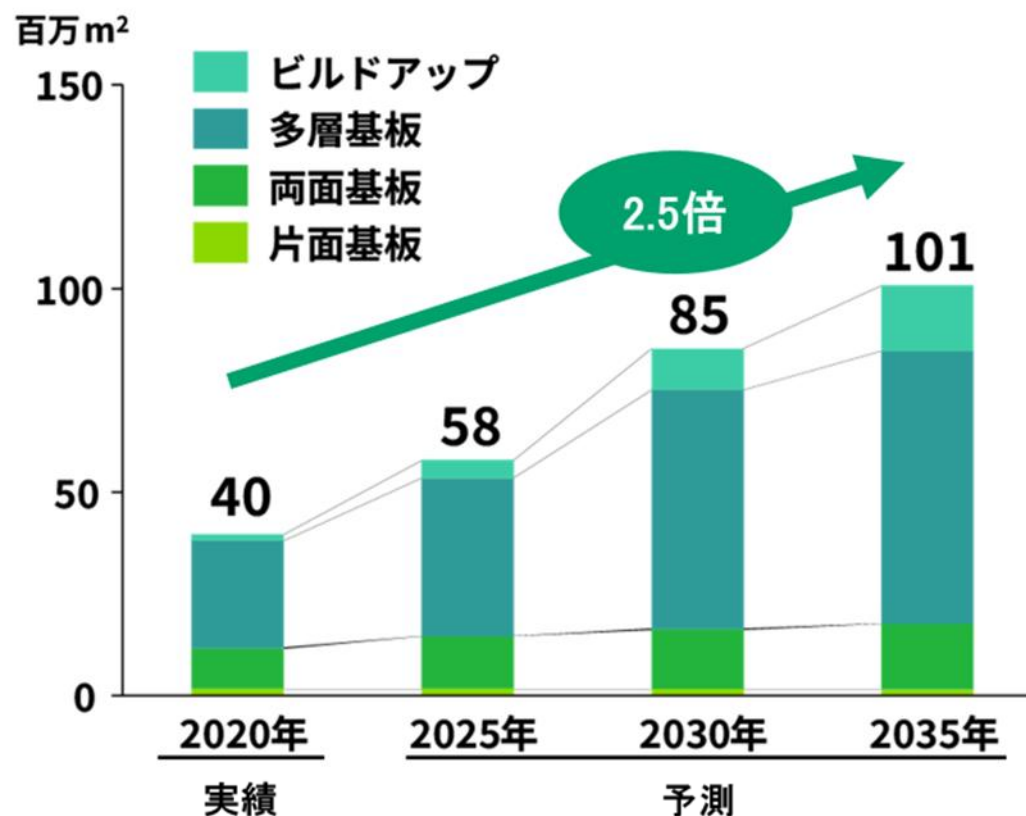


- 次世代モビリティの普及や自動車の電動化・電装化に伴い、自動車1台当たりの基板面積が増加することで、ソルダーレジストの使用量は増加すると想定しています。

自動車1台当たりの
基板面積比^{*1}



車載用プリント配線板
市場規模推移^{*2}

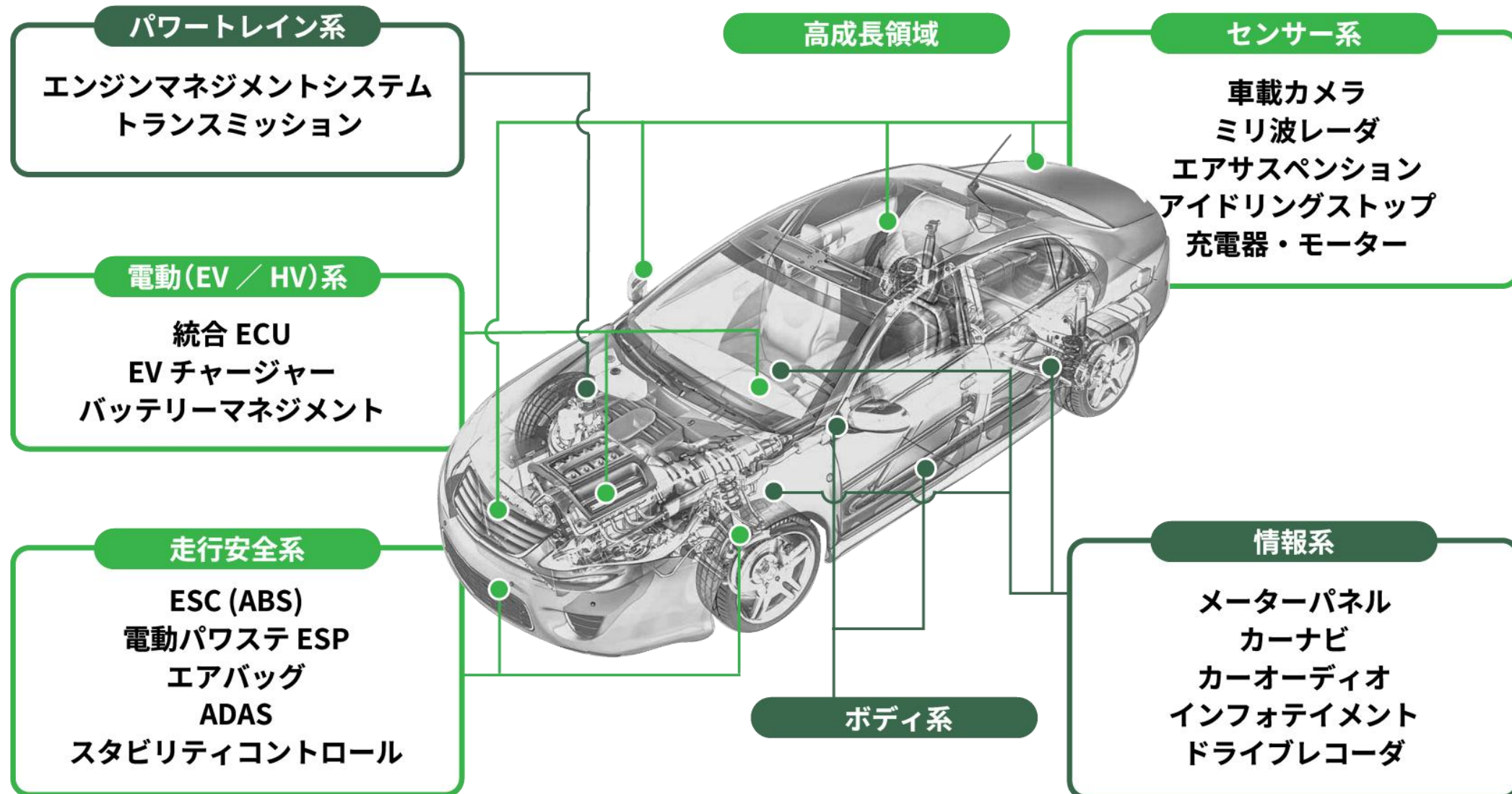


*1: 当社推定値

*2: 出典「車載電装デバイス&コンポーネンツ総調査 2022, 2024」株式会社富士キメラ総研

電動・電装化トレンドに対応した当社製品の採用

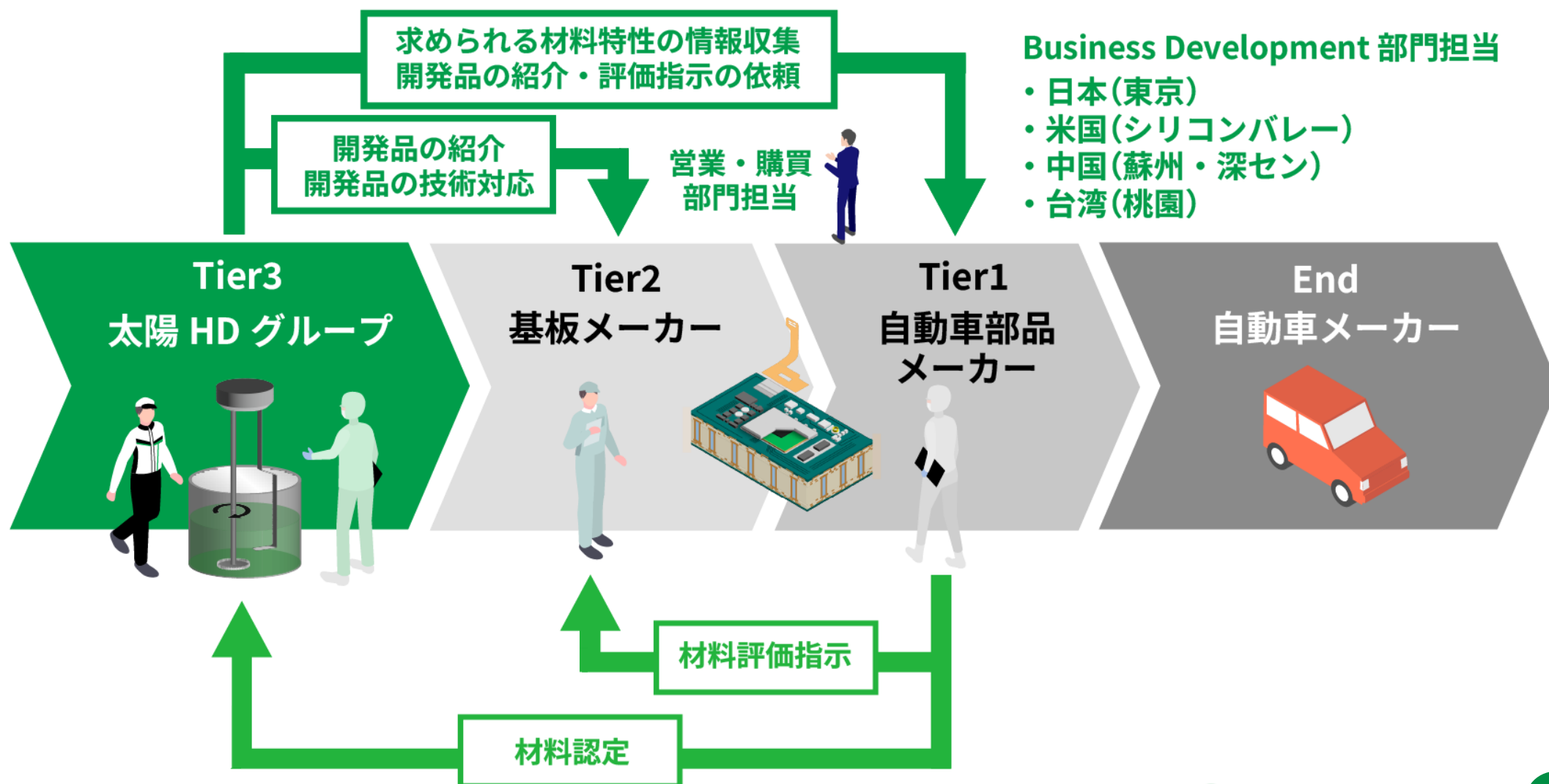
エレキ事業



車載用ソルダーレジストのサプライチェーン

エレキ事業

- 直接の顧客である基板メーカーに加え、ソルダーレジスト等の材料認定・評価指示をするTier1 メーカーとも連携し、事業活動を進めています。



第21回 JPCA賞(アワード)を受賞

エレキ事業

- 「車載半導体パッケージ向け高信頼性ドライフィルムタイプ溶ダーレジスト」で一般社団法人日本電子回路工業会より第21回JPCA賞（アワード）を受賞しました。
- 今年で6年連続の受賞です。

車載半導体パッケージ向け 高信頼性ドライフィルムタイプ溶ダーレジスト

製品の特徴

- 車載半導体向けパッケージ基板用溶ダーレジストに要求される、高い耐久性及び絶縁信頼性を発揮
- **AEC-Q100 Grade0***の品質基準に対応



* AEC-Q100: Automotive Electronics Council (AEC) の定めた車載用電子部品の品質基準。
当該受賞製品は、その中で最も厳しい条件である「Grade0」に対応している。

- 2026年1月21日～23日に開催しているネプコンジャパンにて出展しています。
- ソルダーレジストを含む様々な車載向け次世代製品を紹介しています。

Automotive

車載向け製品群

高信頼性
ソルダーレジスト
High Reliability Photo-Imageable Solder Resist
PSR-4000 AM Series

立体成型基板用
ソルダーレジスト
3D-MD Solder Resist suitable for
molded thermoplastic substrate
S-500 MD Series

感光性カバーレイ
Photo-Imageable Coverlay
FLEXFINER Series

ギャップ埋めインキ
Gap filling Ink
THP-100 GF Series

車載パッケージ基板用
ソルダーレジスト
Solder Resist for Automotive Package Substrate
AUS HE Series

01



車載

車載パッケージ基板の進化に適応した 感光性ソルダーレジスト

Photosensitive solder resist adapted to the evolution of automotive package substrate

車載パッケージ基板用アルカリ現像型ドライフィルムソルダーレジスト
Photo-imageable dry film solder resist for automotive package substrate

PSR-800 AUS HE Series

特徴 FEATURES

- ▶ AEC-Q100 Grade0に対応した材料開発
Material development for AEC-Q100 Grade0
- ▶ 優れた絶縁信頼性
High Insulation reliability
- ▶ 高クラック耐性
High TCT crack resistance
- ▶ ドライフィルムタイプ
Dry Film type

06



パワー
半導体

耐熱、耐電圧に優れた 感光性ソルダーレジスト

Photosensitive solder resist with high heat and voltage resistance

アルカリ現像型ソルダーレジスト Alkali development type solder resist PSR-4000 HT3

PSR-4000 HT3

特徴 FEATURES

- ▶ パワー半導体に最適な耐熱・耐電圧に優れたソルダーレジスト
Solder resist with high heat and voltage resistance for power semiconductor etc
- ▶ 高Tg/低CTEにより、冷熱サイクル時のクラック耐性 (-40deg.C⇔175deg.C, 1000cyc)
High Tg /Low CTE for crack resistance at thermal cycle testing
- ▶ 1000V絶縁耐性 (IPC comb type B Pattern 85deg.C, 85% RH)
1000V Insulation resistance

技術開発センター「InnoValley」

エレキ事業

- 国内における新規開発品は、グループ初の技術開発センターより生み出されています。

技術開発センター 「InnoValley」



知的生産性の向上とコミュニケーションが 活発化する施設内構造



設計デザイン/DRAFT Inc.

当社エレキ事業製品への理解を促す 体験型ショールーム



Historyコーナー



Futureコーナー



Technologyコーナー



医療・医薬品事業

医療・医薬品事業の全体像

医薬事業

- 2018年3月期よりエレクトロニクス事業に次ぐ第2の柱として、医療・医薬品事業に参入しました。

太陽ホールディングス 医療・医薬品事業



太陽ファルマテック
(大阪)

医薬品製造受託業
2019年に事業開始



太陽ファルマ
(東京)

医薬品製造販売業
2017年に事業開始



太陽ファルマアジア
(タイ)

医薬品の包装・外観検査の受託業
2025年4月に設立
2027年3月期下半期より稼働予定



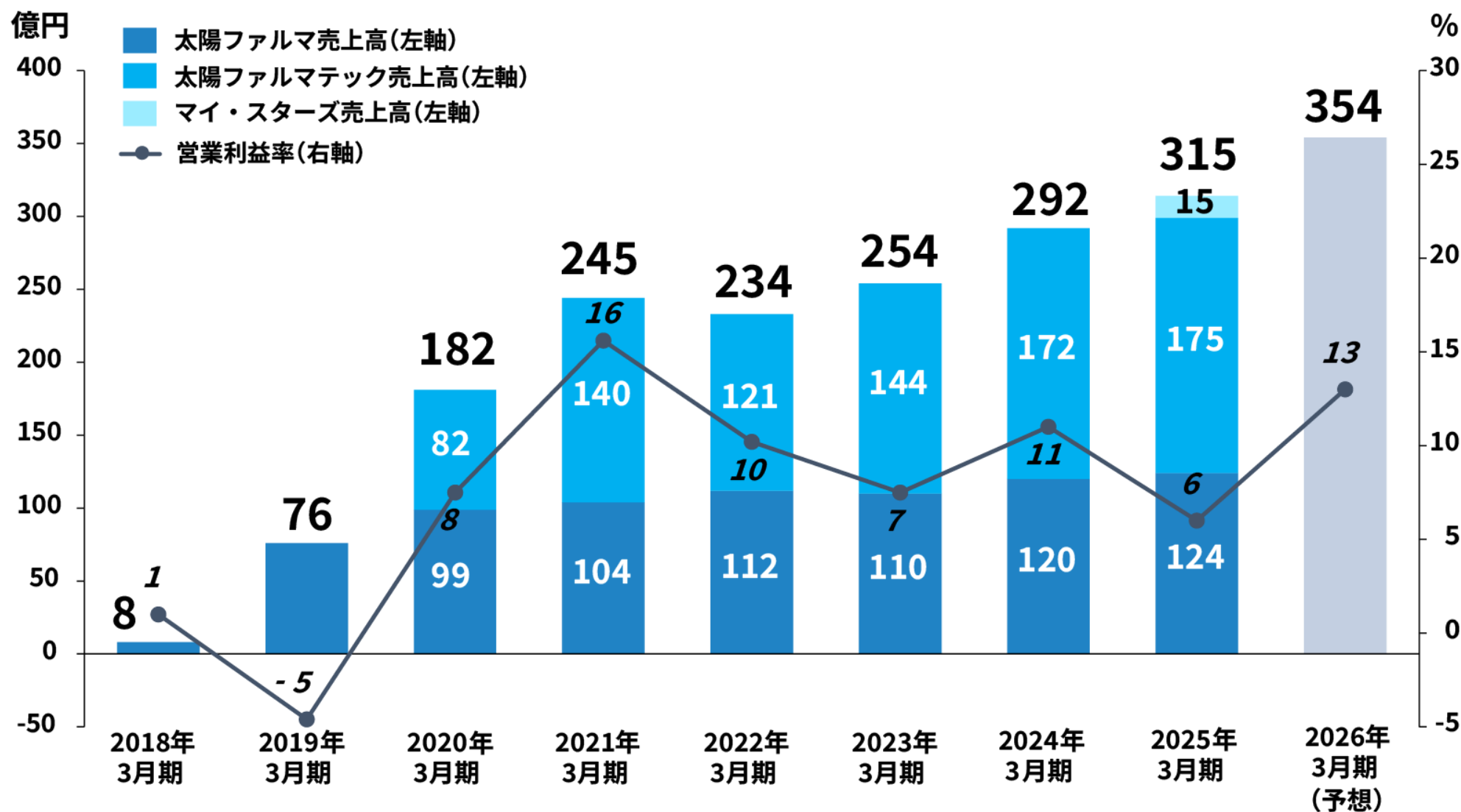
マイ・スターズ
(東京・大阪)

歯科技工製品の製造販売業
2024年4月より連結子会社化

売上高・営業利益率推移

医薬事業

● 医療・医薬品事業は、参入した 2018 年 3 月期より成長を続けています。



医療・医薬品事業の成長戦略

医薬事業

- 医療・医薬品事業では新製品・新技術を追加し、製造販売と製造受託の両輪により、さらなる成長につなげていきます。

海外展開



太陽ファルマ

既存製品の改良、
新製品の開発新たな価値を付加して成長



太陽ファルマテック

既存の高い製造技術に加え、
新たな分野の製造技術を追加し成長



新製品・新技術・新サービス

新治療分野・新技術（遺伝子治療や再生医療等）への投資

M & A

アカデミアとの連携

ベンチャー投資



太陽ホールディングス

太陽ファルマテック株式会社 取り組みのご紹介

90年以上の歴史

医薬事業

1933

第一製薬(株)
高槻工場として開設



2019

太陽ファルマテック
(株)として操業開始



- 固形製剤や注射製剤など、医療現場で使用される多様な医薬品を受託製造しています。

従来型医薬品

経口剤(錠剤)



バイアル



アンプル



プレフィルドシリンジ

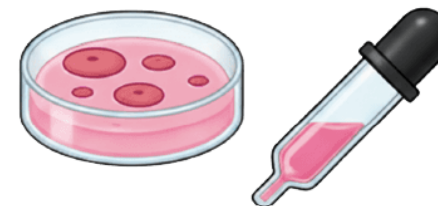


新規モダリティ製品

遺伝子治療薬



細胞製品



太陽ファルマテックの特徴・強み

医薬事業

- 安定供給・高品質・効率的な製造体制をもとに、多種品目の生産を受託しています。

特徴・強み

安定供給

長年の生産実績に基づき安定供給を実現

高品質

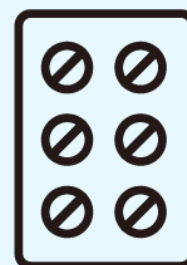
医療現場へ安心して届けられるよう、徹底した品質管理により品質を確保

高効率な製造体制

CMO として培ったコスト対応力や、継続的な改善による効率的なオペレーション

生産品目

固形製剤



約 **30** 品目

注射製剤



約 **50** 品目

- GMP/GCTP* に準拠した設備のもと、遺伝子治療薬の受託製造を行い、従来治療が困難とされてきた疾患への新たな治療法の実用化に貢献しています。

—— 受託製造する遺伝子治療薬 ——



- 当社はアデノ随伴ウイルス (AAV) などのウイルスベクターにより、目的の細胞に治療用遺伝子を直接届ける遺伝子治療薬を受託製造しています。
- 送達された遺伝子が目的の細胞内で正常に働くことにより、病気を治療することができます。

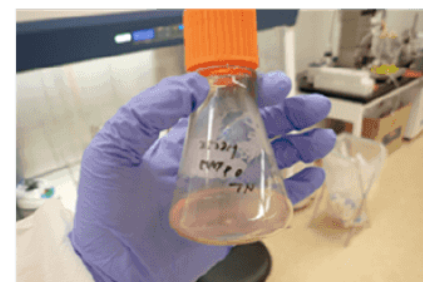
—— 治療が期待される疾患 ——



- 遺伝性網膜疾患
- 筋ジストロフィー
- 脊髄性筋萎縮症 (SMA) など

* 国内外の製造管理及び品質管理基準

開発・製造環境



- GMP/GCTP に準拠し、国内外の細胞製品の CDMO サービスを提供しています。
- パートナーが計画している三次元神経導管の治験用製品を受託製造する予定です。

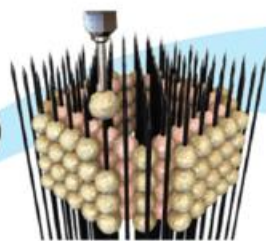
パートナー(サイフェーズ社)の製造技術例

プラットフォーム技術

細胞塊
(スフェロイド)

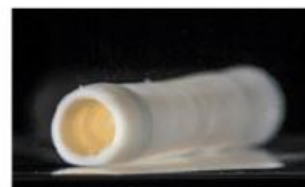


細胞培養



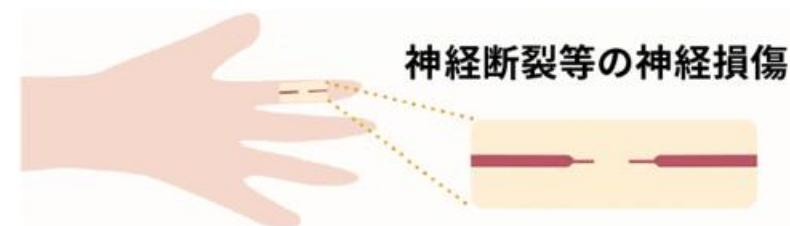
細胞のみで 3D 細胞製品を
作製するプラットフォーム技術

立体的な
細胞構造体



三次元神経導管

治療イメージ



三次元神経導管
の移植



神経が三次元神経導管の空洞部分を伸長



人材の特徴

医薬事業

- 2019 年の発足から積極的に若手社員の採用・育成に取り組み、更なる事業の成長を見据えた育成・体制づくりを続けています。

社員数*

541人
(派遣社員含む)

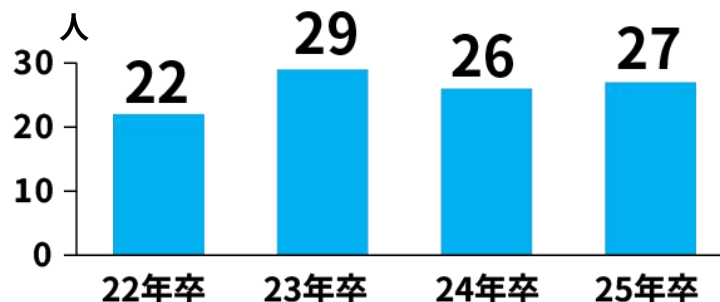
男性 49%
女性 51%

年齢*

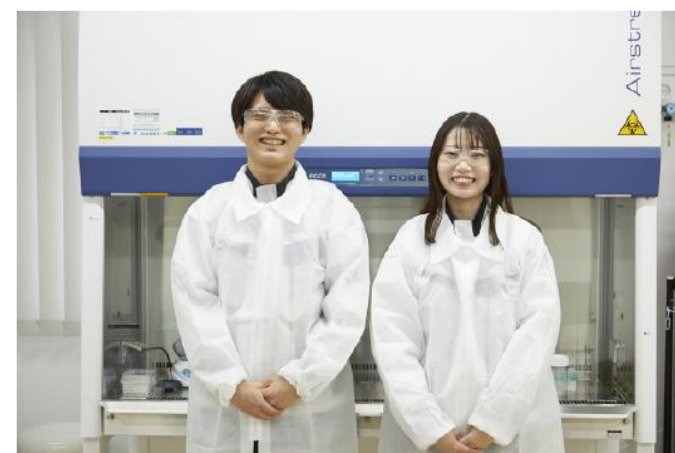
平均 **40 歳**

29歳以下 **30 %**

新卒採用



* 2025年4月時点



会社紹介動画のご案内

医薬事業



(<https://youtu.be/iOkFb4836eI?si=VYiZ1eALLaTSSI0F>)

福利厚生施設「T-LINKS」

医薬事業

- T-LINKSは、社内施設としての利用に加え、災害時には帰宅困難者等の一時滞在施設として利用可能な機能を備えております。

福利厚生施設 「T-LINKS」



社員用の食堂・マシンジムや アリーナ



開設

2022年11月24日

所在地

大阪府高槻市

用途

- ・ 社員用の福利厚生施設
- ・ 災害時の帰宅困難者及び近隣住民の避難施設





人的資本への投資

自律型人材の育成・活用

- 当社では「仕事のやりがい」「公正な評価・給与」「職場環境」の3つをバランス良く整えることで、自律型人材の育成に努めております。

機会提供により従業員の挑戦をサポート



地域社会を含めた外部からの評価も重視



創造性を高め挑戦を加速させる環境の整備



人的資本に関する取り組み事例と指標

- 当社では、従業員一人ひとりの自律を促し、多様な人材がそれぞれの特性や能力を最大限活かせるよう、職場環境や社内の教育体系の整備などに取り組んでいます。

継続的な学び
への支援

図書費補助費用

年間 **24** 万円/人 

性別を問わない
機会提供

女性管理職比率

22.2% 

男女育休取得
の促進

男性の育休取得率

83.3% 

セミナー・研修制度
の強化と継続

セミナー・研修費用

年間 **31** 万円/人 

中途採用
の強化

中途採用比率

48% 

健康経営
の促進

健康維持促進手当

年間 **3.6** 万円/人 

HD 単体・2025 年 3 月期実績



株主還元・資本政策

投資環境の改善と株主還元の強化

- 株式分割により投資しやすい環境を整備いたしました。
- 上期業績予想の上方修正を受け、中間配当を増配し、株主還元を強化しました。

株式分割

効力発生日

2025年12月1日

分割比率

1 : 2

最低
投資金額*1

分割前

92万円/100株

↓ 1/2

分割後

46万円/100株

増配*2

2026年3月期
第2四半期末 配当金

予想*3

72円50銭/株

↓ +10円

実績

82円50銭/株

期末配当も株主還元方針を踏まえ、
業績に応じて柔軟かつ機動的な対応を検討

*1：2025年11月26日の終値9,225円/株を参考価格として算定

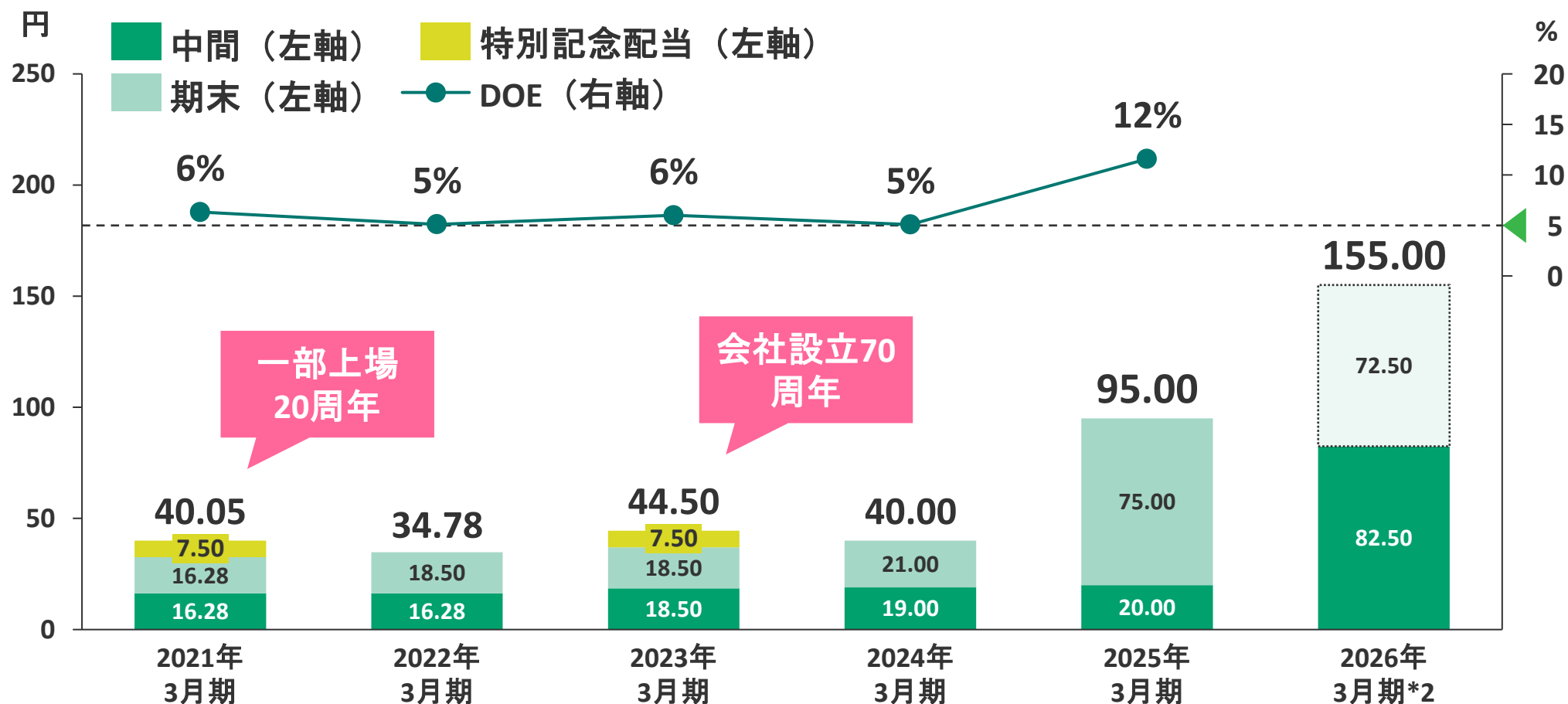
*2：本金額は、2025年12月1日付で実施した普通株式1株につき2株の割合による株式分割後の金額

*3：2025年4月30日公表

株主還元方針 – DOE

- 連結決算を基準に株主資本配当率（DOE） 5%以上を維持します。
- 今年度通期の配当金は、昨年度通期と比べて増配を見込んでいます。

1株あたりの配当金*1・DOEの推移



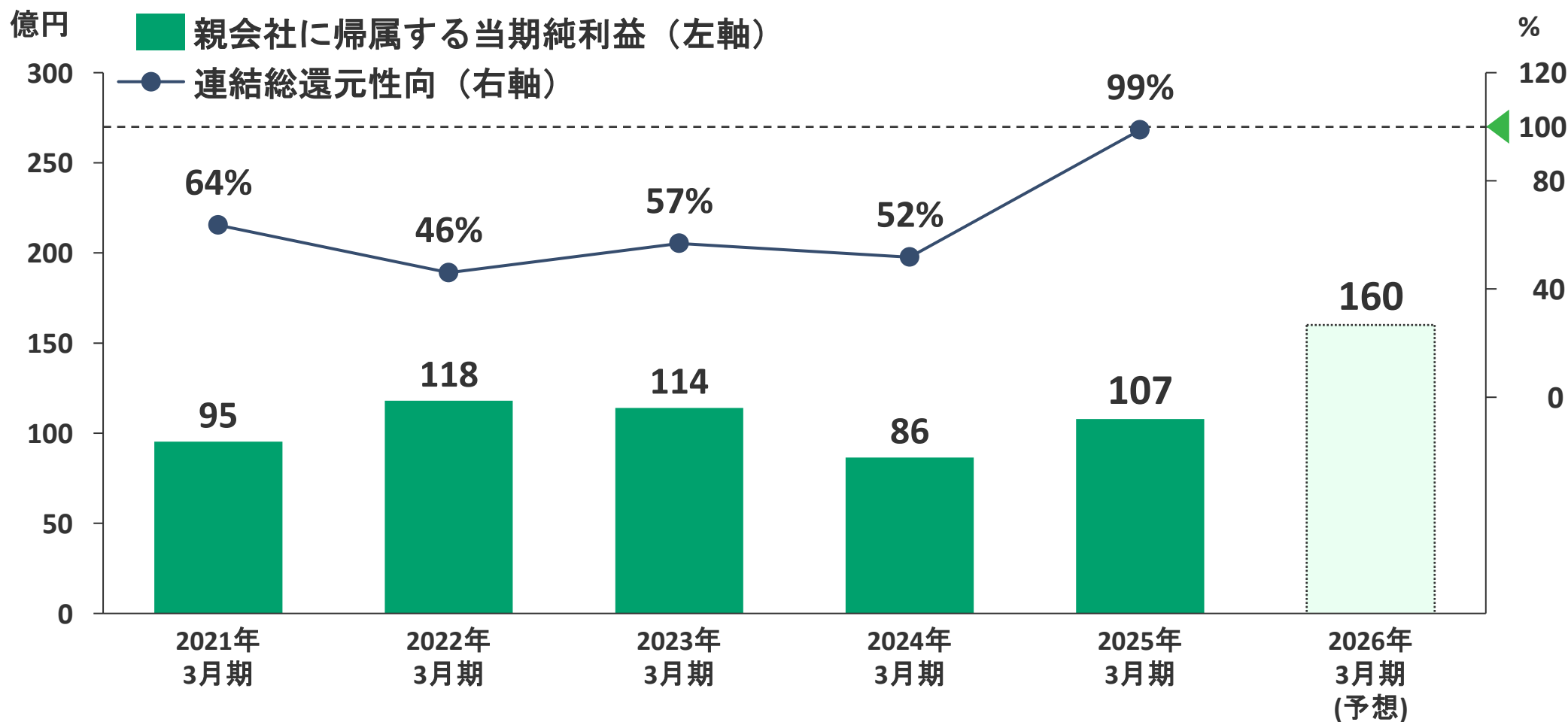
*1：当社は、2021年10月1日および2025年12月1日付で、普通株式1株につき2株の割合で株式分割を実施しています。
本グラフでは2021年3月期の期首に当該株式分割が実施されたものとして算定しています。

*2：中間配当はすでに実施しており、期末配当は会社予想です。

株主還元方針 – 連結総還元性向

- ROE改善に向け、少なくとも2028年3月期まで、連結総還元性向100%を目安とした株主還元を実施いたします。

当期純利益・連結総還元性向の推移





結びのご挨拶

ご清聴ありがとうございました

当社は、長期的な視点に立った経営を通じて、
持続的な成長と企業価値の向上に取り組んでまいります。

「統合報告書 2025」のご案内

ステークホルダーの皆さまに、太陽グループの価値創造に向けた事業活動や特徴的な取り組みをご理解いただくため、統合報告書を発行しております。

当社 HP よりご一読いただけますと幸いです。

<https://www.taiyo-hd.co.jp/jp/investor/library/annualreport.html>

主な内容

- トップメッセージ・対談
- 価値創造のあゆみ・価値創造モデル
- 長期経営構想 Beyond Imagination 2030
- 価値を生み出す事業活動
- 環境への取り組み・社会とのつながり

